

基板製造仕様

番号	項目	摘要	単位	通常基板	備考
1	基板材料			アルミ・銅(取り寄せ)	取り寄せとなるが銅基板も可
2	最大基板サイズ	W×D	mm	500×650	
3	原版サイズ	W×D(複数ある場合は、全て記入をお願いします)	mm	520×680	
4	層数	2,4,6,8,10,12(最大層数)		1層のみ	両面は外注
5	工法	貫通スルーホール	可/不可	不可	外注であれば対応可
6		IVH	可/不可	不可	
7		ビルドアップ	可/不可	不可	
10	基板厚	最少～最大(層数で変更がある場合はそれも記入願います)	mm	1.0、1.5、2.0を常備(絶縁層は80μ)	その他の厚みは取り寄せ
11	板厚公差		-	±0.15mm	
12	銅箔厚	外層	μ	35	その他の厚みは取り寄せ
13	銅箔厚	内層	μ	不可	
14	導体幅		mm	フィルム:0.1、DI:0.075	
15	導体間幅		mm	フィルム:0.1、DI:0.075	
16	アニュアリング(annular ring(width))	外層	mm	フィルム:0.1、DI:0.075	
17	(ランド径とドリルビット径の差)	内層	mm	不可	
18	小径Via仕様	外層ランド径	mm	不可	
19		内層ランド径	mm	不可	
20		ドリル径	mm	不可	
21	最大スルーホール径		mm	不可	
22	穴径公差	ドリル径	mm	±0.05	
23		スルーホール穴径(銅めっき後)	mm	不可	
24		無電解金めっき	mm	±0.05	
25		電解金めっき	mm	±0.05	
26		水溶性プリフラックス	mm	±0.05	
27		はんだレベラー	mm	不可	
28	穴位置精度	穴-穴間	mm	±0.05	
29	アスペクト(板厚/ドリル径)			不可	
30		無電解金めっき	可/不可	可	ボンディング金めっきも可
31	表面処理	電解金めっき	可/不可	可	ボンディング金めっきも可
32		水溶性プリフラックス	可/不可	可	
33		はんだレベラー(共晶/Pbf)	共/F	不可	水溶性プリフラックスを推奨
34		エポキシ系樹脂	可/不可	不可	
35	Pad ON Via(Viaの穴埋め)	導電性樹脂	可/不可	不可	Pad on VIAではないが、埋めるのは可能
36		レジスト	可/不可	不可	
37	コネクタ部メッキ処理	基板にコネクタ端子を作成する場合	可/不可	可	
38	レジスト処理	フォトタイプ 精度	mm	フィルム:±0.1、DI:±0.05	
39		フォトタイプ 最少幅(残りシロ)	mm	フィルム:0.1、DI:0.05	
40		印刷タイプ 精度	mm	不可	
41		印刷タイプ 最小幅(残りシロ)	mm	不可	
42		レジスト色	色	緑、白、黒、青、赤	
43	外形加工精度	Φ2mm以上のドリルを使用することが条件		±0.2	要望があれば±0.1も可
44	Vカット仕様	位置精度	mm	±0.2	外注にて対応
45		残り板厚最少	mm	0.2	外注にて対応
46	ミシン目加工	最小幅	mm	2	
47	検査方法	通電検査(インピーダンス検査除く)	可/不可	可	
48		インピーダンス検査	可/不可	可	
49		AOI光学検査	可/不可	可	
51	UL規格	UL094など、満たしている基準名		不可	
52	環境対応	RoHS	可/不可	可	
54	ガーバーフォーマット指定	RS274X	可/不可	可	
55		RS274D	可/不可	可	
56		その他(指定名称を記入願います)		DXF.DWG	